

Bienvenido a O-lider

Somos fabricantes profesionales de PCB con más de diez años de experiencia. Productos Range-Single, doble lado, PCB de múltiples capas, PCB flexible y MCPCB. Podemos proporcionar un servicio de prototipo rápido en 24 horas, 4-8 laptales en 48-96 horas de producción de HRS.

Los orificios de la placa de cobre Mínimo .025 AVG, .020 min .. Los agujeros pueden no estar conectados

Paquete con una película de burbujas transparente incolora, 25 piezas / bolsa, coloque desecante en flanco, coloque la tarjeta indicadora de humedad en el lado superior

Descripción del producto

Detalles Rápidos

Lugar de origen	Guangdong China (continental)	Nombre de la marca	O-lider
Material de base	FR-4,, Aluminio	Espesor de cobre	0.5oz-5oz
Min. Tamaño del agujero	0.2mm	Min. Grosor de línea	0.2mm
Acabado de superficies	Inmersión de oro, OSP, liderazgo libre.	precio	\$ 0.1- \$ 10
aplicable a	LED, Teléfono Móvil, Aire Acondicionado, Lavadoras	personaje	PCB de control industrial
certificados	ISO9001, UL, RoHS, SGS	Q / ctn	10pcs-100pcs
peso	0.01kg -5kg	Moq	10pcs
Número de modelo	Fabricante de PCB de PWB Bank Power Bank	Espesor del tablero	0.1-5mm
color	azul, rojo, verde, negro.	Min. Espaciado entre líneas	0.2mm
tipo de despido	requisito del cliente	Talla	0.01m3-10m3

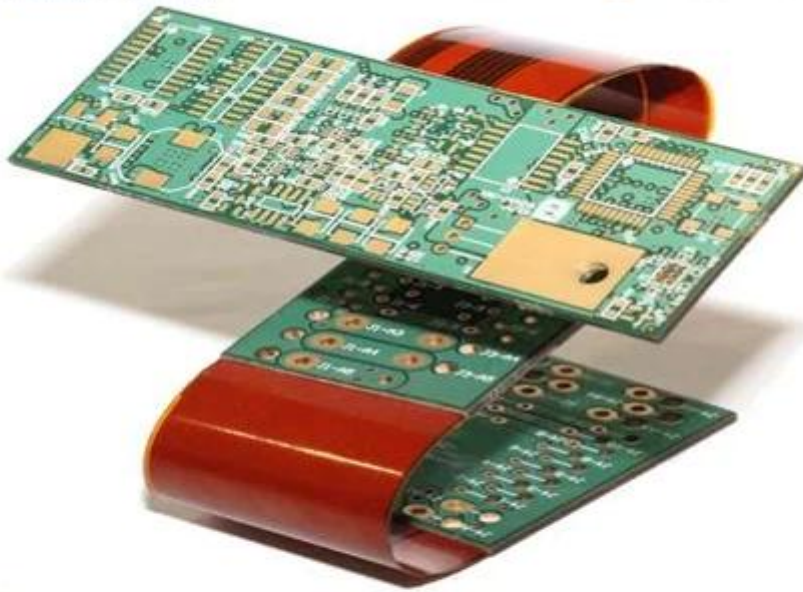
Empaquetado y entrega

Detalles del empaque:	16 años Professional OEM PCB Placa Fabricante
Detalle de la entrega:	7-12days

China fabricante de PCB rígido-flexible

Articulo	2014		2015 ~ 2016		2017 ~ 2018	
	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra	Volumen	Muestra
Recuento de capas	32	42	38	44	42	48
Min Line / Space (µm)	50/50	40/45	40/45	40/40	35/40	35/35
Agujero de taladro min diámetro (mm)	0.15	0.10	0.15	0.10	0.15	0.10
Relación de aspecto de pth	14: 1	16: 1	16: 1	18: 1	18: 1	20: 1
N + c + n	4 + C + 4	5 + C + 5	5 + C + 5	6 + C + 6	5 + C + 5	6 + C + 6
Cualquier interconexión de capa	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6	5 + 2 + 5	6 + 2 + 6
Llenado de placa a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-

Min. Espesor del núcleo (excluir el cobre) (µm)	50	40	40	30	40	30
Min. Diámetro del taladro láser (µm)	75	sesenta y cinco	sesenta y cinco	50	50	40
A través de enterrado Agujero / apilado a través de	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Material	FR4, Megtron, Nelco, Rogers, cobre pesado, etc.					
Capacitador incrustado PCB	SÍ	-	SÍ	-	SÍ	-
Proceso de superficie	Hasl, enig, OSP, plata, plata, estaño de inmersión, sin plomo. Flash Gold, Gold Finger Plating, Chapado de oro duro selectivo, Máscara de soldadura peelable, tinta de carbono					



www.o-leading.com

Nuestro equipo





Certificaciones



2017/26 2016VZL430354 - Wiring, Printed - Component

ONLINE CERTIFICATIONS DIRECTORY

ZPMV2.E490354
Wiring, Printed - Component

For enhanced search functionality, please visit UL's [iQ™ Family of Databases](#).
Click on a product designation for complete information.

[Page Bottom](#)

Wiring, Printed - Component

See General Information for Wiring, Printed - Components

O-LEADING SUPPLY CHAIN CO LIMITED
Fortune Building, Nanheng West Road
Room 1313
Huizhou, Guangdong 516211, CHINA

E490354

	Cond Width				Max				Max			
	Min	Min	Cond		SS/	Area	Solder		Oper	Flame	Heat	
	Min	Edge	Thk	DS/	Diam	Limits	Temp			UL796		
Type	mm(In)	mm(In)	mic(mil)	DSO	mm(In)	C	sec	C	Class	DSR	I	
HullBayer (mass laminate) printed wiring boards.												
O-LEADING-401												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	12.7 (0.5)	260	10	230	V-0	-	-	
O-LEADING-407												
	0.08 (0.003)	0.2 (0.008)	17 (0.67)	D5	9.7 (0.4)	260	10	170	V-0	AB	-	
HullBayer printed wiring boards.												
O-LEADING-408												
	0.125 (0.005)	0.125 (0.005)	12 (0.47)	D6	50.8 (2.0)	260	20	130	V-0	AB	-	
Single layer printed wiring boards.												
O-LEADING-002												
	0.76 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	105	V-0	AB	-	
O-LEADING-003												
	0.38 (0.015)	1.14 (0.045)	34 (1.34)	D5	19.1 (0.8)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-033												
	0.15 (0.006)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D5	25.4 (1.0)	260	10	120	V-0	AB	-	
O-LEADING-205												
	0.2 (0.004)	0.3 (0.012)	34 (1.34)	D6	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	
O-LEADING-206												
	0.15 (0.006)	0.33 (0.013)	17 (0.67)	D5	69.8 (2.7)	260	10	130	V-0	AB	-	

* - CTI marking is optional and may be marked on the printed wiring board.

Making: Company name or file number and type designation. May be followed by a suffix to denote factory identification or burning test designation.
Last updated on 2017-01-27

Questions? Print this page Terms of Use Page Top

Implications: Using this information to verify the accuracy of the data is the user's responsibility. ZPMV2.E490354 - Wiring, Printed - Component



Test Report

No. CAVE1805164701

Date: 03 Apr 2018

Page 2 of 8

Test Results:

Test Part Description:

Specimen No. **SGS Sample ID** **Description**
SN1 CAN18-051647.001 Green "PCB"

Remarks:

- (1) 1 mg/kg = 1 ppm = 0.0001%
- (2) MDL = Method Detection Limit
- (3) ND = Not Detected (< MDL)
- (4) "-" = Not Regulated

RoHS Directive (EU) 2015/863 amending Annex II to Directive 2011/65/EU

Test Method: With reference to IEC 62321-4:2013+A1:2017, IEC 62321-5:2013, IEC 62321-7-2:2017, IEC 62321-6:2015 and IEC 62321-8:2017, analyzed by ICP-OES, UV-Vis and GC-MS.

Test Item(s)	Limit	Unit	MDL	Det
Cadmium (Cd)	100	mg/kg	2	ND
Lead (Pb)	1,000	mg/kg	2	9
Mercury (Hg)	1,000	mg/kg	2	ND
Hexavalent Chromium (CrVI)	1,000	mg/kg	8	ND
Sum of PBBs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Dibromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Trisbromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Pentabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Hexabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Heptabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Octabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Nonabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Decabromobiphenyl	-	mg/kg	5	ND
Sum of PBDEs	1,000	mg/kg	-	ND
Monobromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Dibromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Trisbromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Tetrabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND
Pentabromodiphenyl ether	-	mg/kg	5	ND



SGS is a global leader in testing, inspection and certification services. We are committed to providing our clients with the highest quality of service and the most accurate and reliable results. Our services are recognized by the international community and are a key factor in the success of many of the world's leading companies. For more information, please visit our website at www.sgs.com.

Empaquetado y entrega

detalles del empaque	16 años Professional OEM PCB Placa Fabricante
Detalle de la entrega	7-12days



Preguntas más frecuentes

1. ¿Cómo se asegura la calidad de O-lider?

Nuestro estándar de alta calidad se logra con lo siguiente.

- 1.El proceso está estrictamente controlado por las normas ISO 9001: 2008.
2. Uso extensivo del software en la gestión del proceso de producción.
3. Equipos y herramientas de prueba de estado de arte. P.ej. Sonda voladora, inspección de rayos X, AOI (inspector óptico automatizado) y TIC (pruebas en circuito).
4. Equipo de garantía de calidad condicados con proceso de análisis de caso de falla.
5. Capacitación y educación del personal continuo.

2. ¿Cómo lleva el O-Liderar su precio competitivo?

Durante la última década, los precios de muchas materias primas (por ejemplo, cobre, productos químicos) se habían duplicado, triplicado o cuadruplicado; La moneda china RMB se había apreciado 31% sobre dólar estadounidense; Y nuestro costo laboral también aumentó significativamente. Sin embargo, la O-liderado ha mantenido firmes nuestros precios. Esto posee enteramente a nuestras innovaciones para reducir el costo, evitando los desechos y la mejora de la eficiencia. Nuestros precios son muy competitivos en la industria al mismo nivel de calidad.

Creemos en una asociación de ganar-ganar con nuestros clientes. Nuestra asociación será mutuamente beneficiosa si podemos proporcionarle una ventaja en el costo y la calidad.

3. ¿Qué tipos de tablas pueden realizar el proceso de O-líder?

Tableros comunes FR4, High-TG y tableros sin halógenos, Rogers, Arlon, Telfon, Aluminio / Tableros a base de cobre, PI, etc.

4. ¿Qué datos son necesarios para la producción de PCB?

Es mejor proporcionar datos en formato Gerber 274-X. Además, también se puede procesar CAM350, CAD, PROTEL 99SE, PADS, DXP y EAGLE.

5. ¿Cuál es el flujo de proceso típico para PCB multicapa?

Corte de material → Película seca interna → Grabado interior → Interior AOI → Multi-Bond → Pila de la capa → Perforando → PTH → PLATABLE PANEL → Película seca exterior → Patrón de placa → Grabado exterior → Outer AOI → Máscara de soldadura → Marca de componentes → Acabado de la superficie → Enrutamiento → E / T → Inspección visual.